

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2026-011

天水华天科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	
办公地址	甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360 号	甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360 号	
传真	0938-8632260	0938-8632260	
电话	0938-8631816	0938-8631990	
电子信箱	htcw2000@163.com	caiping.yang@ht-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期，公司的主营业务为集成电路封装测试，目前公司集成电路封装产品主要有 DIP、SOT、SOP、QFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、FO、PLP、2.5D/3D 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

公司为专业的集成电路封装测试代工企业，经营模式为根据客户要求及行业技术标准和规范，为客户提供专业的集成电路封装测试服务。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

2025 年，在集成电路行业快速发展的大背景下，公司订单同比大幅增长，各季度营业收入均实现正增长，并于四季度实现新高，公司经营效益和盈利能力稳步提升。2025 年，公司共完成集成电路封装 628.80 亿只，同比增长 9.33%，晶圆级集成电路封装 211.99 万片，同比增长 20.16%；完成营业收入 172.14 亿元，同比增长 19.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.11 亿元，同比增长 15.30%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	43,121,135,906.41	38,235,948,588.77	12.78%	33,751,820,450.19
归属于上市公司股东的净资产	17,812,985,255.24	16,658,594,709.34	6.93%	15,849,983,538.60
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	17,213,915,293.79	14,461,617,106.21	19.03%	11,298,245,259.39
归属于上市公司股东的净利润	710,508,576.43	616,251,021.39	15.30%	226,323,275.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,439,267.39	33,419,406.53	499.77%	-308,146,446.12
经营活动产生的现金流量净额	3,472,079,653.35	3,097,973,379.05	12.08%	2,411,209,475.02
基本每股收益（元/股）	0.2200	0.1923	14.40%	0.0706
稀释每股收益（元/股）	0.2164	0.1923	12.53%	0.0706
加权平均净资产收益率	4.14%	3.79%	0.35%	1.43%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,568,772,026.90	4,211,482,498.81	4,599,535,005.83	4,834,125,762.25
归属于上市公司股东的净利润	-18,528,648.84	245,007,189.96	316,158,475.98	167,871,559.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,864,070.32	74,732,617.72	118,777,452.87	89,793,267.12
经营活动产生的现金流量净额	660,703,298.92	922,438,576.46	1,032,037,819.98	856,899,957.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	380,035	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	474,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	22.30%	727,844,408	0	不适用	0	
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	3.15%	102,914,400	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.12%	69,104,079	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	37,761,666	0	不适用	0	
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	26,018,066	0	不适用	0	
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	其他	0.72%	23,502,804	0	不适用	0	
广东恒阔投资有限公司	国有法人	0.65%	21,147,200	0	不适用	0	
莫常春	境内自然人	0.54%	17,558,728	0	不适用	0	
国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	15,961,093	0	不适用	0	
胡娟	境内自然人	0.41%	13,335,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名股东中，莫常春在报告期末通过普通证券账户持有公司股份 13,100 股，通过投资者信用账户持有公司股份 17,545,628 股；胡娟在报告期末通过普通证券账户持有公司股份 404,000 股，通过投资者信用账户持有公司股份 12,931,800 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

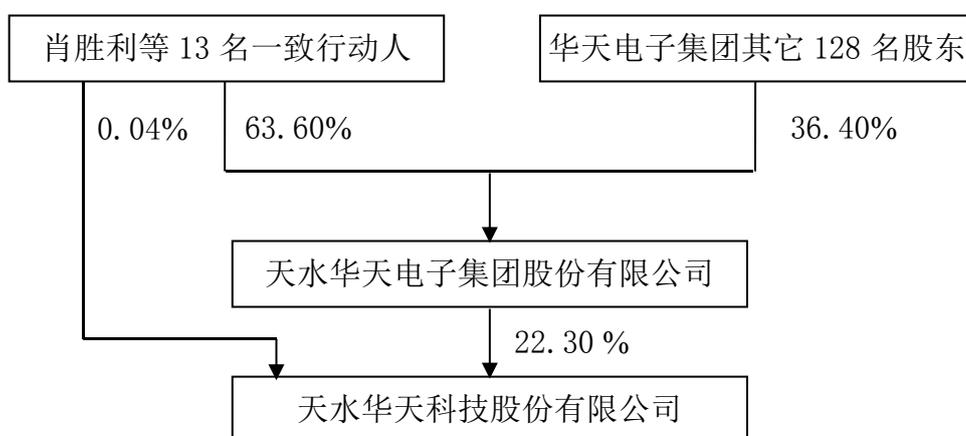
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2025 年公司主要工作开展情况如下：

(1) 深入践行以客户为中心的发展理念，牢牢把握新能源汽车与人工智能产业快速发展的战略机遇，聚焦国内 CPU、GPU 等重点客户拓展与产业化落地，持续强化汽车电子产品战略方向。报告期内，公司进一步优化战略客户管理机制，集中优势资源提升客户服务水平，全年战略客户销售目标完成率达 108%；同时，公司不断细化全流程价格管理，持续推进金线、基板等材料价格与封装产品价格联动机制，维持公司封装产品利润水平。

(2) 坚持先进封装技术的研发与产业化，加快推进板级封装、2.5D 等平台技术研发，顺利完成 ePoP/PoPt 高密度存储器及面向智能座舱与自动驾驶的车规级 FCBGA 封装技术的开发，同时持续推进 CPO 封装技术研发。为满足 Bumping、WLP、FOPLP 等先进封装业务的发展需要，华天江苏与盘古半导积极补充管理、技术与工程团队，目前两家公司均已进入生产阶段。

公司于报告期内获得授权专利 48 项，其中发明专利 44 项。

(3) 不断推进质量文化建设，全面开展精益六西格玛管理，通过质量绩效评审、质量异常管控、落地稽核与持续改善等工作，逐步构建集团化客户质量管理体系，加强业务连续性管理，强化制程稳定性，推动质量管理体系高效运行与持续改进，不断提升封装产品质量与客户满意度。

(4) 围绕“减少人工干预、提升执行一致性”的目标，开展自动化与信息化融合，对比公司及相关子公司自动化建设的优势和短板，总结自动化项目的实施成效与推广经验，加速推进公司智能产线建设，同时，通过材料与设备降耗、国产化应用、效率优化及优秀实践推广等举措，降低生产成本，持续提升公司自动化水平和生产效率。

(5) 2025 年 9 月，公司启动收购华羿微电事项，截至本报告披露日，收购华羿微电事项已通过公司董事会和股东会审议，并获得深圳证券交易所受理。收购华羿微电将延伸功率器件研发设计与自有品牌业务，拓宽封装测试业务布局，有利于提升综合竞争力与盈利水平。

(6) 报告期内，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期等待期届满，股票期权开始行权。股票期权激励计划的开展，充分调动了公司核心技术和业务人员的积极性、创造性及责任感，促进公司经营目标的实现。